

GUIP 산학협력 전문가 현황

플랫폼 현황	플랫폼명	경기도 반도체 인력양성 · 기술협력 대학혁신 플랫폼
	전문 분야	반도체PKG/부품 분야

산학협력 전문가 정보	전문가 정보	성함	유봉영 교수	
		전공	금속공학(석사), 재료공학(박사)	
		소속 / 학과	공학대학 / 재료화학공학과	
		직위	교수	
		이메일	byyoo@hanyang.ac.kr	
		연락처	031-XXX-XXXX	
	산학협력 정보	전문분야	기술사업화 및 기술이전, 현장실습, 국책사업, 기술애로기술	
		기술개발 지원가능분야	반도체 패키지 도금 (TSV, RDL, TGV, Cu-Cu bonding), 전기화학 기반 공정, 표면 처리	
		지식재산권	-접촉식 표면 처리를 통한 선택적 구리 충전 방법 (10-2348708): Micro contact printing 방식을 이용하여 반도체 트렌치 패턴 내부에 선택적으로만 도금하는 기술 -TSV 기판 상의 범프 형성 방법(10-2060360): Self-assembled monolayer를 이용하여 리소그래피와 reflow를 생략하는 Sn 범프 형성 기술 -반도체 소자의 제조 방법(10-2301933): 반도체 패키지 배선에 적용 가능한 전해연마를 평탄화 공정으로 사용	
		기술이전	-글라스 관통형 전극기판 제작용 고속 Cu Filling 도금액 노하우에 관한 기술이전: 고속 TGV 도금 공정을 위한 도금액 첨가제 및 도금 조건에 대한 기술이전 -실리콘 표면 에칭방법 및 시드층 형성 방법에 관한 기술이전: 금속 나노 입자를 사용한 실리콘 표면 에칭 방법에 대한 기술이전 -전해습식 증착법을 이용한 고연성 금속 박막 증착 기술에 관한 기술이전: 고연성 금속 박막 제작을 위한 도금 조건(도금액, 온도, 전류 등)에 대한 기술이전	
	산업체경력	기관명	삼성전자	
		담당업무	반도체 공정 개발	
	창업	창업연도		
		회사명		
		분야		